

深圳市艾汇科技有限公司

天线测试报告

Test report

2025年12月27日

目 录 (catalogue) :



- 1.项目信息 (Model Information)
- 2.公司介绍 (Company profile)
- 3.无源驻波及匹配 (Passive and Matching)
- 4.3D有源测试数据 (3D Active Test Data)
- 5.环境处理 (Environmental treatment)
- 6.总结 (Summary)



1、项目信息 (Model Information)

项目名称	XYC-F900-V4.0	RF	
Model Name		联系电话	
Antenna Type		Band	
Model pictures :			

2、无源驻波及匹配 (Passive and Matching)

2.1 无源测试示意图

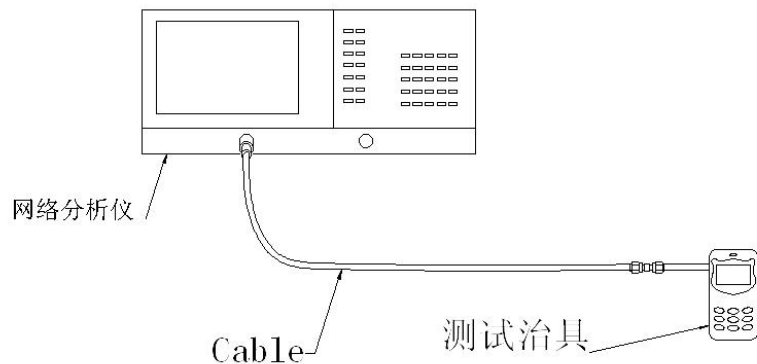
S11测试方法说明

测试设备：

网络分析仪(E5071C 30k-8.5Ghz)

测试方法：

用一根**50欧姆CABLE**电缆从仪器测试端口导出，使用校准件校准后连接样机制具的**SMA**接头，记录相关频点对应的回波损耗和驻波比。



2.2有源测试示意图

3D测试系统: 屏蔽暗室

测试环境: 温度 $22^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$, 湿度 $50\% \pm 15\%$

测试设备: 测试无源数据时, 使用网络分析仪 **Agilent E5071C**

测试有源数据时, 使用综测仪 **8960/CMW500**

总全向辐射功率 (TIRP)

$$TIRP \equiv \frac{\pi}{2NM} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} [Eirp_{\theta}(\theta_i, \phi_j) + Eirp_{\phi}(\theta_i, \phi_j)] \sin(\theta_i)$$

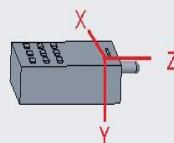
总全向辐射灵敏度 (TIRS)

$$TIRS \equiv \frac{2NM}{\pi \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} \left[\frac{1}{EIS_{\theta}(\theta_i, \phi_j)} + \frac{1}{EIS_{\phi}(\theta_i, \phi_j)} \right]} \sin(\theta_i)$$

E1: XZ的切面 PHI=0

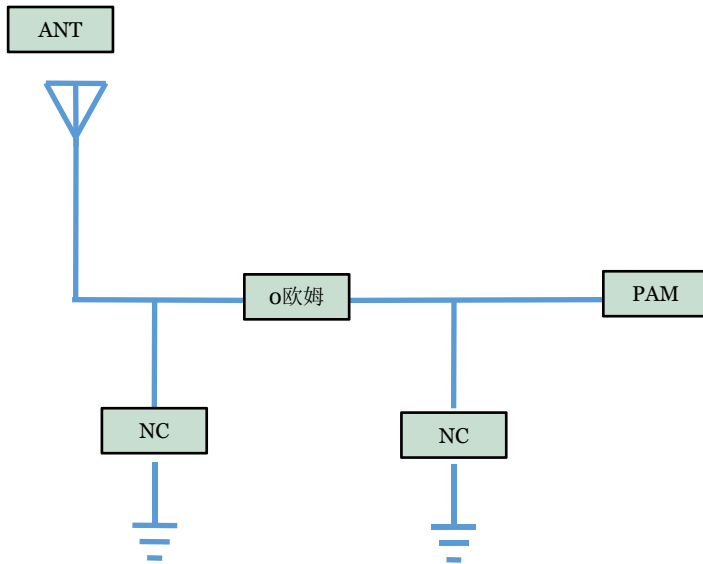
E2: YZ的切面 PHI=90

H: XY的切面 Theta=90



以喇叭天线为参考

2. 3天线匹配 (Matching Circuit)



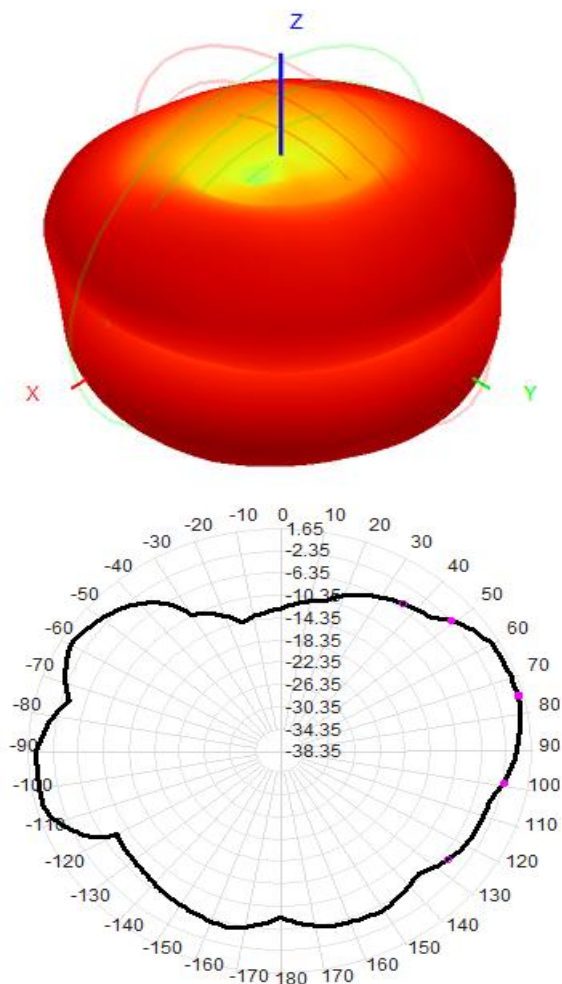
Antenna Photo & Length (mm)



(160mm*28mm)

Note: Original string 0 ohm,
from antenna ---- series 0 ohm
resistor ---- PA

5.1 主天线无源数据

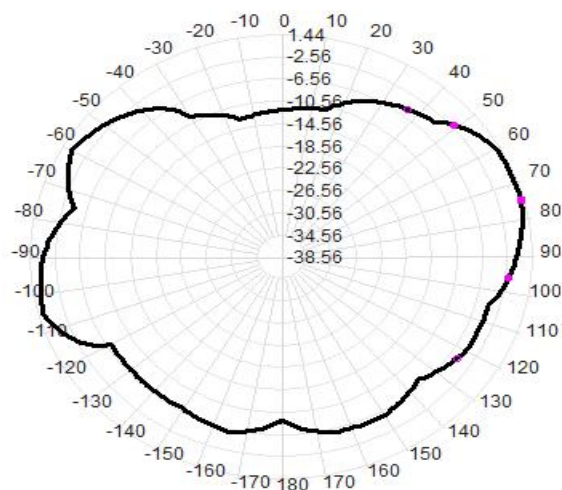
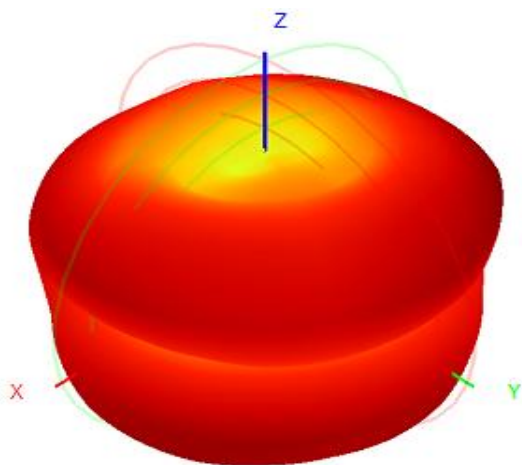


测试数据:

WIFI 2.4G

Freq(MHz)	Efficiency (%)	Gain (dBi)
2400	55.25	1.25
2410	55.41	1.47
2420	57.65	1.35
2430	59.65	1.44
2440	61.41	1.54
2450	60.54	1.52
2460	62.63	1.44
2470	64.15	1.65
2480	59.64	1.23

5.1 主天线无源数据

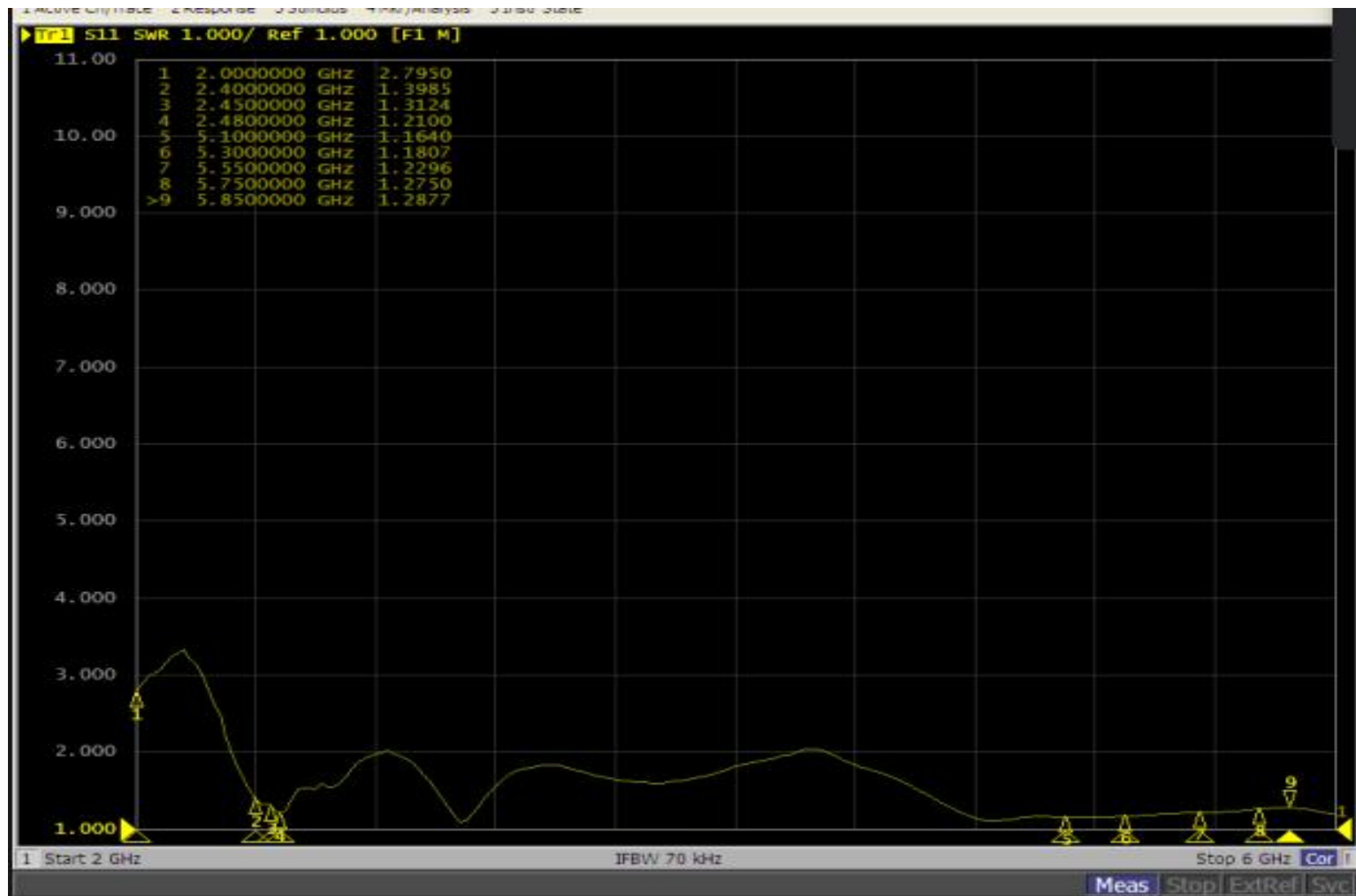


测试数据:

WIFI 5.8G

Freq(MHz)	Efficiency (%)	Gain (dBi)
5000	59.54	1.41
5100	57.85	1.30
5200	59.41	1.25
5300	54.71	1.40
5400	55.63	1.21
5500	57.15	1.31
5600	59.65	1.05
5700	60.22	1.30
5800	61.41	1.25
5850	62.30	1.44

5.1 主天线 SWR



深圳市艾汇科技有限公司



注：1. 此份报告依据调试样机实际调试及测试情况所得，其中环境处理、天线位置以及各器件装配位置不可随意更改；

2. 样机所使用物料若有变动，需及时反馈我司做再次验证；

3. 敏感器件清单：

TP（材质，涂层，走线等）

屏（放大电路，LED，排线设计等）

壳料（天线装配方式，结构干涉，壳料材质，天线位置高度及面积等）

主板（主板传导，射频电路匹配、PA、双功器、滤波、LNA，电源电路等）

摄像头、电池、马达、MIC、指纹识别模块等

4. 因调试样机数量少或仅有一台，部分概率性问题不能完全找出，建议量产前先小批试产排查问题点（如闪屏花屏，喇叭杂音，TP跳点，黑屏死机，信号跳水等）

Thank you